



## LOTPASTE SC 111

Wasserlöslich, Typ ISO 1.2.3.C; RE L0

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC 111 ist ein hochentwickeltes SMT-Produkt, dessen Flußmittel vor und nach dem Löten leicht entfernbar ist. Ihrer Entwicklung liegen die hohen Anforderungen der Kunden auf dem Gebiet Hybrid-Schaltungen und SMT, insbesondere im HF-Bereich, als auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, EN-, IPC-, und MIL-Normen zugrunde.

Die SC 111 ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem Weichlotpulver, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf wasserlöslicher Harzbasis, das der RE L0 nach J-STD 004 entspricht. Sie ist halogenfrei und gehört zu den allerbesten wasserwaschbaren Lotpastentypen.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Lagerzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile:

- \*SC 111\* Weicher, nur mit Wasser restlos entfernbarer Rückstand
- \*SC 111\* Stundenlang nicht nachlassend hohe Klebrigkeit
- \*SC 111\* immun gegen Luftfeuchte - tagelang!
- \*SC 111\* Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang !
- \*SC 111\* Exzellente Lötresultate mit glänzenden Lötstellen auch nach dem Waschen!
- \*SC 111\* Für „fine pitch“-Anwendungen sehr zu empfehlen

### PHYSIKALISCHE DATEN

Metallpulver: bevorzugte Legierungen 62Sn\36Pb\2Ag und 63Sn\37Pb:

Bezeichnung der Korngröße

nach SC	Nach DIN 32 513	Durchmesser	mesh size
Fein (T3)	Kl. 3	20-45µm	325-500
Superfein (T4)	Kl. 4	10-25µm	450-700

**VISKOSITÄT** (Pa.s) +/-10% gemessen nach Brookfield RVT-DV-II Viskosimeter bei 90% Metallgehalt:

Korngröße	Viskosität
Fein (T3)	900

**OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR)** und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Die Werte von S.I.R. entsprechen denen vom Träger der Leiterplatten, da die Fluxrückstände völlig und restlos nur mit Wasser ohne Zusätze entfernt werden können!

## Qualifikationen

Die Lotpaste SC 111 ist eine sogenannte wasserlösliche Paste, die die höchsten Anforderungen auf diesem Gebiet in Erfüllung bringt. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 (F-SW 33) entsprechende, Rückstände, die **wegen ihrer Wasserlöslichkeit ausnahmslos von der Leiterplatte entfernt werden müssen!!!**

## Lagerung

Ungeöffnetes Gebinde bei ca. 20°C (RT) : 6 Monate **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, wie auch immer, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird.

## Verbraucherhinweise

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst fest verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren als Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen darf man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15-100 mm/s.

Merke(!) Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in Ihrer Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 91% Metallgehalt empfohlen

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen. Aus diesem Grund empfehlen wir den **SC Schablonenreiniger**. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen auch unter Schutzgas aufschmelzbar.

## WASCHHINWEIS !

Das Flux unserer SC 111 ist vor und nach dem Löten **biologisch völlig abbaubar! Die Belastung des Abwassers , z.B. nach dem Gebrauch von 5 kg der SC 111, ist geringer als ein einziger Waschvorgang in einem durchschnittlichem Haushalt.**

## So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste

Legende	Pastentyp	Korngröße	Legierung	Flußmittelanteil	Gebindegröße
z.B.	SC 111	T3	62/36/2Ag	10%	500g
	SC 111	T3	63/37	10%	200g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste(SC...) L-Sn62Pb2Ag / F-SW 32 / 90-3 200g(Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße ; D-84034 Landshut  
Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020  
e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.